

您的位置: [首页](#) > [行业资讯](#) > [行业动态](#)[行业动态](#)[市场走势](#)[技术前沿](#)[政策法规](#)

中国电科43所三代半导体封装工艺实现航空航天领域国内首次应用

2023-07-06 来源: 中国电科 浏览次数: 263

加关注 433

分享至:

近日,中国电科43所“活性金属钎焊(AMB)基板一体化封装”先进工艺实现了电路、布线、封装等多项技术升级,相关技术指标达到国际先进水平。该工艺应用于三代半导体领域,43所在此技术基础上进一步开发的多款AMB基板一体化封装产品,实现航空航天领域的国内首次应用。

AMB基板一体化封装先进工艺聚焦航天航空、新能源汽车、光伏风电、轨道交通等领域,解决模块整体散热等问题,43所突破关键技术,将工艺升级后,实现了产品封装体积、重量的有效降低和载流能力的大幅提升,拓宽了AMB一体化外壳的应用领域和产品类型。

下一步,43所将面向国家重大战略需求,聚焦三代半导体芯片散热封装等领域,进一步完善产品谱系、拓展产品类型,聚力开发新材料制备技术,实现AMB产品全产业链自主研发,助力我国大功率模块产业快速发展。

上一篇: [江苏省省长许昆林调研亨通海洋信息技术创新...](#) 下一篇: [成都理工大学-永星电子教学实习基地成功揭牌](#)

地址:北京市石景山路23号中电大厦B座710室 电话:010-68638969

网站邮箱: icceca@ic-ceca.org.cn 京ICP备12052994号-1 京公网安备110107000141 宣传服务

Copyright China Electronic Components Association.中国电子元件行业协会 All rights reserved